

導電銀膠

AR-100 ATH-10

Conductive Paste AR-100 ATH-10 是熱固化性樹脂及高純度微細銀粉之均勻分散的單液型導電材料。因為底黏度產品，導電性佳，針對 PC 板(銅箔)加工時表裡(Conductive Material for through holes) 可導通之材料。

☆ 優點

含有中高沸點之溶劑，印刷作業性及糕模厚形成時，內部乾燥性佳。
銀粉粒徑及結合劑樹脂均勻分散在內，膠材料在底黏度狀況下，不會沉澱及分離。
針對 PC 板(銅箔基材)的附著性佳，有高硬度及耐熱性佳。
導電銀粉的粒徑控制及，適當的混合下，有底阻抗及穩定的導電膜。

☆ 特性

項目	規格	實驗方法
外觀	中黏度銀灰色膠體	目視
黏度 at 25°C Viscosity	50~80dPa. S	Visco-tester VT-06
TI 值	2~5	Brookfield DV2T CPA52Z
固化條件 Curing condition	150~160°C × 30 分	烤箱 Oven
附著性 Adhesion	100/100 銅箔上 Copper foil	Cross Cut Peeling
表面硬度 Hardness	≥ 3 H (銅箔上)	鉛筆硬度 Pencil Hardness
耐溶劑性 Solvent Resistance	沒有脫落 沒有溶解	IPA 溶劑(浸漬)
面積阻抗 Resistivity	≤ 50 mΩ/□	膜厚/20um Film thickness
煮水試驗 Boiling Test	±20%	1 小時煮沸後
耐熱性 Heat Resistance	無變色 無溶解	260°C*5 秒/3dip

*上述數值為蔽司之研究實驗值，而非保證數據

☆ 使用方法及取樣上之注意事項

Thinner

- 請務必使用原樣品。若需要稀釋的話，請使用專用稀釋劑「Carbitol Acetate」。
- 使用前或添加稀釋劑之後，請均勻攪拌後使用之。
- 塗佈適合網印刷，基材料塗布面必須要清潔後再使用
使用網目(150mesh)，乳劑厚度(50um)
- 欲清洗使用後之網版、治具及容器，請使用溶纖劑(Cellosolve)及酯類(Ester)溶劑。
- 產品取樣時，請務必穿著護具於抽氣良好之作業場所下操作之。
- 產品保存期限不開封的狀況下 25°C 以下 6 個月。

Shelf Life : 6 months since date of manufacture

Contact: **Selmag Enterprise Co Ltd**

Tel: 02-2918-9913 Attn: Eliza Hu Ext.11 E-mail: elizahu@selmag.com.tw Mobile: 886-0938-120-186